

江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中邮电子—吴文吉、万玮 申万一徐巡 创金合信—周志敏、张小郭 招商证券—谌薇 兴业证券—刘培锐 华泰证券—汤仕翥 中泰电子—康丽侠、张心阳 平安电子—徐碧云 富国基金—王佳晨 汇丰晋信—周宗舟 建信理财—张婧 易方达基金—黄鹤林 永赢基金—任桀 国金证券—戴宗廷 上海同犇投资—李晓芬 西部利得基金管理有限公司—侯文生 广东正圆私募基金管理有限公司—陈泽敏 浙江益恒投资管理有限公司—钱坤 北京神农投资管理股份有限公司—汪洋 建信养老金管理有限责任公司—高月 中邮创业基金管理股份有限公司—王瑶 上海人寿保险股份有限公司—卓鑫辉 LCRICH CAPITAL MANAGEMENT—闫慧辰 上海途灵资产管理有限公司—赵梓峰 致顺投资—朱贺凯 东方证券资产管理有限公司—陈思远 才华资本—唐毅
会议时间	2025 年 10 月 24 日 10:00—11:00（中邮电子）
地点	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号行政楼 4 楼会议室
上市公司接待人	公司副总经理、董事会秘书：张家铨先生；公司监事、董秘办主

员姓名	任、证券事务代表：沈志鹏先生；公司证券事务与投资者关系管理主管：虞晶晶女士；公司证券事务与投资者关系管理专员：朱天娇女士、黄淮婷女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司副总经理、董事会秘书张家铨先生介绍公司概况和2025年三季度报告营收情况。 各位投资者好！欢迎大家参加此次的调研活动。 公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的业务体系，业务模式以IDM模式为主。公司是集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率（电力）半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片，分别为：晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片（包括：TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电容、压敏电阻等）、二极管器件和芯片（包括：整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、IGBT器件及组件、碳化硅器件等。公司晶闸管系列产品、二极管及防护系列产品采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，即集功率半导体芯片设计、制造、器件设计、封装、测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。公司MOSFET采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式和部分产品委外流片相结合的业务模式，目前，芯片（8英寸、12英寸）部分为委外流片，部分器件封测代工。 2025年前三季度，在客户端的支持与关心下，在公司全体员工的共同努力下，公司实现营业收入25.02亿元，较上年同期增加24.70%；第三季度实现营业收入9.01亿元，较上年同期增加21.19%。 第三季度报告期内，归属于上市公司股东的净利润10,007.63万元，比上年同期减少15.65%；年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润34,691.95万元，年初至报告期

末比上年同期增加4.30%。

公司总资产本报告期末85.61亿元，比上年度末增加6.32%；归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末59亿元，比上年度末增加1.54%。

二、主要交流问题

1、公司 2025 年前三季度晶闸管、防护器件和 MOS 的营收情况？

答：年初至报告期末，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入4.22亿，毛利率为42.92%，营业收入较上一年度同比减少1.92%，占公司2025年前三季度主营业务收入17.10%；公司防护器件（芯片+器件）营业收入8.39亿，毛利率为30.63%，营业收入较上一年度同比增长28.77%，占公司2025年前三季度主营业务收入33.99%；公司MOSFET（芯片+器件）营业收入12.06亿，毛利率为29.17%，营业收入较上一年度同比增长35.16%，占公司2025年前三季度主营业务收入48.91%。

2、公司2025年第三季度晶闸管、防护器件和MOS的营收及毛利率情况？

答：报告期内，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入1.39亿，毛利率为39%，营业收入较上一年度同比减少7.58%，占公司2025年第三季度主营业务收入的15.60%；公司防护器件（芯片+器件）营业收入2.97亿，毛利率为30.19%，营业收入较上一年度同比增加19.77%，占公司2025年第三季度主营业务收入的33.43%；公司MOSFET（芯片+器件）营业收入4.53亿，毛利率为21.85%，营业收入较上一年度同比增加37.67%，占公司2025年第三季度主营业务收入的50.97%。

3、请问公司 2025 年第三季度下游领域占比情况？

答：公司的下游客户分布十分广泛,客户众多。按照产品的应用领域的不同,大致分为这几个类别:工业（安防、低压电器、电力模块、电力仪表、电源电机、光伏储能等）、汽车电子、通

信、消费（电源管理、家电、照明、智能终端等）。2025年第三季度各下游领域占比情况为：工业40.47%；消费领域41.40%；汽车13.11%；通信1.95%；其他3.07%。

4、请问车规级的 MOSFET 产品有多少型号？汽车类下游的主要客户有哪些？车规级 MOSFET 及其它器件的销售情况？

答：汽车电子领域是公司未来着重发展的下游应用领域之一，目前可供选择的車規級 MOSFET 產品近 200 款，該領域的產品在持續研發更新中。公司已量產百餘款車規級 MOSFET，其中 JMSH040SAGQ 憑借捷捷微電自有知識產權的 JSFET 芯片、全銅框架和跳線封裝工藝，性能突出，符合汽車行業的嚴苛標準，在長期可靠性、封裝尺寸、功率及性能方面均獲得業內認可，已廣泛應用於國內 tier-1 汽車零部件供應商的轉向、燃油、潤滑、冷卻等系統。汽車類下游的主要客戶有羅思韋爾、霍尼韋爾、東風科技、埃泰克、科世達、比亞迪、三花、華域、Nidec 等。車規 MOSFET 的銷售持續創高，同比超 20% 增長，環比超 10% 增長；其他的防護類車規級產品同比也超 30% 增長。

5、公司四季度訂單趨勢？

答：未來上下游價格有望逐步調整恢復，公司四季度有信心能完成預期的銷售目標。公司的下游應用領域十分廣泛，產品種類齊全，客戶眾多，目前在手訂單飽滿。

6、公司光耦項目的進展和未來市場的大概情況？

答：2027 年國內市場預測達 92 億元，快速增長，CAGR%9% 左右。光電耦合器屬於傳統隔離產品，市場成熟度高、占隔離器 85% 以上銷售比例，當前以歐美日、台系為主，大陸近几年眾多封裝廠在上馬光耦產品，未來會逐漸國產化，但以華潤微、鎔威特、奧倫德等為代表的芯片供應商只能提供晶體管輸出、可控硅輸出、少量 PVG 輸出光耦，產品性能還有提升空間，在驅動類、高速光耦上目前大陸企業沒有芯片設計能力，部署低中高阶完整產品線，可獲得較高的市場地位和營收。目前公司光耦產品已有小批量生產。

	7、公司三季度管理费用同比增加的原因是什么？ 答：三季度管理费用同比增加3000万不到，其中包括绩效分享激励和折旧费用。 8、公司资本开支的计划是怎样的？ 答：公司主要项目例如车规级封装产线项目、高端功率半导体器件产业化项目，“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线”等项目都已建设完成，处于产能爬坡期。短期内无重大资本开支计划。
附件清单（如有）	无
日期	2025-10-27